

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2007年12月13日 (13.12.2007)

PCT

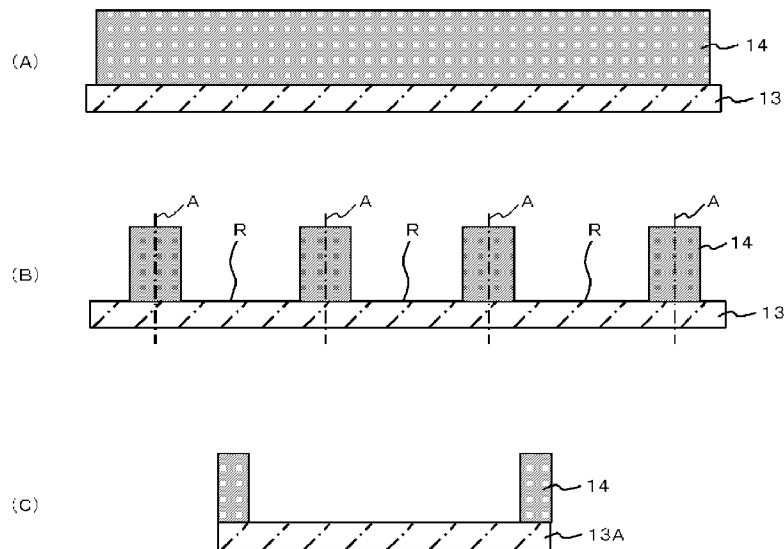
(10) 国際公開番号
WO 2007/141909 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 31/02 (2006.01) H01L 23/02 (2006.01)
C08F 299/00 (2006.01) H01L 23/10 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/000578
- (22) 国際出願日: 2007年5月30日 (30.05.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-159005 2006年6月7日 (07.06.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋豊誠 (TAKAHASHI, Toyosei) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 楠木淳也 (KUSUNOKI, Junya) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 溝一登 (OONAMI, Kazuto) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 杉野光生 (SUGINO, Mitsuo) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 川田政和 (KAWATA, Masakazu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 高山梨恵 (TAKAYAMA, Rie) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

/ 続葉有 /

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING LIGHT RECEIVING APPARATUS

(54) 発明の名称: 受光装置の製造方法



(57) Abstract: A method for manufacturing a light receiving apparatus (1) is provided with a step wherein a resin layer (14), which contains a light curing resin to cover a transparent substrate (13), is arranged on the transparent substrate (13) wherein a plurality of transparent substrate sections (13A) are integrated; a step wherein light is selectively applied at least on a resin layer (14) for development, and the resin layer (14) is left at least on a region on the transparent substrate (13) surrounding a portion equivalent to a region facing a light receiving section (11) of the transparent substrate section (13A); a step wherein the transparent substrate (13) is divided by the unit of the transparent substrate section (13A), and the transparent substrate sections (13A) are obtained; a step wherein a base substrate (12) is divided by the unit of the base substrate section (12A) and a plurality of base substrate sections (12A) are obtained; and a step wherein the base substrate sections (12A) and the transparent substrate sections (13A) are bonded through a resin layer (14).

(57) 要約: 受光装置1の製造方法は、複数の透明基板部13Aが一体化した透明基板13上に、透明基板13を覆うように光硬化性樹脂を含有する樹脂層14を設ける工程と、樹脂層14に対し、選択的に光を照射し、現像処理して、少なくとも

/ 続葉有 /



WO 2007/141909 A1



会社内 Tokyo (JP). 大橋誠司 (OOHASHI, Seiji) [JP/JP];
〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友
ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京
都渋谷区恵比寿西 2 - 1 7 - 1 6 代官山 TK ビル
1 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH,
BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則 4.17 に規定する申立て:

- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する
申立て (規則 4.17(ii))
- 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

も透明基板 1 3 のうち、透明基板部 1 3 A の受光部 1 1 と対向する領域に該当する部分を囲む領域に樹脂層 1 4 を
残す工程と、透明基板 1 3 を透明基板部 1 3 A 単位に応じて分割し、複数の透明基板部 1 3 A を得る工程と、ベー
ス基板 1 2 をベース基板部 1 2 A 単位に応じて分割し、複数のベース基板部 1 2 A を得る工程と、ベース基板部
1 2 A および透明基板部 1 3 A を、樹脂層 1 4 を介して接合する工程とを含むものである。